

## 組織委員会

委員長：藤本公三（大阪大学）  
副委員長：青柳昌宏（国研）産業技術総合研究所  
岩本 知広（茨城大学）

委員：  
瀨美幸一郎（大阪大学）、荒井 栄司（大阪大学）、大熊 秀雄（有）エイチ・ティー・オー）、小勝 俊巨（日本電気（株））、河野 英一（株）河野エムイー研究所）、小林紘二郎（一財）電子科学研究所）、齋藤 重正（株）GYシステムズ）、佐藤 武彦（大阪大学）、佐藤 了平（大阪大学）、堀川国夫（富士電機（株））、嶋田 勇三（ナミック（株））、菅沼 克昭（大阪大学）、清野 武寿（株）東芝）、芹沢 弘二（千住金属工業（株））、高橋 康夫（大阪大学）、高橋 良和（東北大学）、高山 智生（三菱電機（株））、武井 利泰（株）シャバンユニックス）、竹本 正（大阪大学）、田中 敏宏（大阪大学）、津久井 勤（リサーチラボ・ツクイ）、寺前 俊哉（株）日立製作所）、西田 一人（パナソニック（株））、貫井 孝（大阪大学）、廣瀬 明夫（大阪大学）、益子原 學（株）ザイキューブ）、松村 慶一（インフィテックエム（株））、南 二三吉（大阪大学）、南尾 匡紀（パナソニック（株））、宮崎 則幸（北九州市環境エレクトロニクス研究所）、矢野 映（株）富士通研究所）、山本治彦（富士通CT（株））

## 実行委員会

委員長：加柴良裕（大阪大学）  
副委員長：山誠樹（株）富士通研究所）  
福本信次（大阪大学） 森 三樹（東京大学）

委員：  
青島 正貴（トヨタ自動車（株））、朝倉 義裕（神戸市立工業高等専門学校）、安部 元（三菱電機（株））、新井 進（信州大学）、安藤 哲也（室蘭工業大学）、池田 徹（鹿児島大学）、石橋 正朗（凸版印刷（株））、出田 吾朗（三菱電機（株））、一山 靖友（日鉄テクノロジー（株））、井上 雅博（群馬大学）、岩田 剛治（大阪大学）、上西 啓介（大阪大学）、上村泰紀（株）富士通研究所）、海老原 伸明（NECスペーステクノロジー（株））、大口 達也（日本アビオニクス（株））、大村 悦二（大阪大学）、小川 泰史（ソマール（株））、小椋 智（大阪大学）、折井 靖光（長瀬産業（株））、梶原 隆志（エスベック（株））、鎌田 信雄（化研テック（株））、菊谷 義治（芝浦工業大学）、木村 文信（東京大学）、木村 裕二（株）村田製作所）、久保 雅男（パナソニック（株））、高齋 光弘（千住金属工業（株））、小林 竜也（群馬大学）、小山 真司（群馬大学）、阪元 智朗（オムロン（株））、佐藤 強（株）東芝）、佐名川 佳治（パナソニック（株））、佐野 智一（大阪大学）、柴崎 正訓（株）タムラ製作所）、荘司 郁夫（群馬大学）、高尾 尚史（株）豊田中央研究所）、高岡 英清（株）村田製作所）、高橋 邦夫（東京工業大学）、富岡 泰造（株）東芝）、富村 壽夫（熊本大学）、中田 裕輔（カルソニックカンセイ（株））、西浦 正孝（大阪大学）、西川 宏（大阪大学）、久田 隆史（日本アイ・ピー・エム（株））、平井 維彦（株）ケーヒン）、福江 高志（金沢工業大学）、藤原 伸一（株）日立製作所）、松岡 洋（日本電気（株））、松坂 壮太（千葉大学）、松嶋 道也（大阪大学）、松林 良（パナソニック（株））、圓尾 弘樹（パナソニック スマートファクトリーソリューションズ（株））、水野 潤（早稲田大学）、満倉 一行（日立化成（株））、村井 淳一（三菱電機（株））、村山 啓（新光電気工業（株））、森 貴裕（株）ADEKA）、森永 英二（大阪大学）、両角 朗（富士電機（株））、安田 清和（大阪大学）、山内 啓（群馬工業高等専門学校）、山口 敦史（パナソニック（株））、山田 博之（株）デンソー）、山中 公博（中京大学）、山根 常幸（株）東レリサーチセンター）、山部 光治（株）東芝）、山本 哲也（株）東芝）、横沢 伊裕（宇部興産（株））、和田 剛優（株）弘輝）、渡邊 聡（藤倉化成（株））、渡邊 潤（長野沖電気（株））、渡邊 裕彦（富士電機（株））

（依頼中を含む）



＜問合せ先＞  
（一社）スマートプロセス学会  
エレクトロニクス生産科学部会 事務局  
＜ものづくりリエゾンオフィス（MLO）＞

E-MAIL：mate@sps-mste.jp  
PHONE：06-6878-5628 FAX：06-6879-7568

First Circular and Call for Papers 論文募集

# Mate 2020

26th Symposium on  
“Microjoining and Assembly Technology in Electronics”  
28-29 Jan. 2020, Yokohama

## 第26回

## 「エレクトロニクスにおけるマイクロ 接合・実装技術」シンポジウム

日時：2020年1月28日(火)、29日(水)  
場所：パシフィコ横浜 会議センター  
横浜市西区みなとみらい1丁目1-1

主催：  
（一社）スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会  
（一社）溶接学会 マイクロ接合研究委員会

共催：  
（一社）エレクトロニクス実装学会  
（公社）化学工学会 エレクトロニクス部会  
（一社）レーザ加工学会

協賛：  
応用物理学会、軽金属学会、精密工学会、電子情報通信学会、  
日本機械学会、日本金属学会、日本材料学会、日本溶接協会

（依頼中を含む）

### 開催主旨

日本のエレクトロニクス産業は、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。



### 論文募集

開催主旨に従い、シンポジウムを開催いたします。つきまして、独創性に富むオリジナル論文（学術論文、研究開発論文）を募集しております。各講演の発表時間は18分（発表12分、質問6分）、発表件数は約100件を予定しております。投稿希望の方はWEB申込みしていただくようお願い申し上げます。学術論文、研究開発論文の区分等に関しましては、申込者への採択通知送付時に投稿規定とともに送付させていただきます。また申込み多数の場合は、ポスター発表にまわる場合もございます。

### ポスター発表募集

発表者と聴衆が十分に議論できる場として、ポスター発表を設けております。ポスターでの発表希望の方はWEB申込時にポスター発表を選択していただくようお願い申し上げます。発表件数は約20件を予定しております。

### 表彰

本シンポジウムで発表された優秀な論文に対してシンポジウム賞（優秀論文賞、奨励賞）、また優秀ポスター賞および学生の発表に対して優秀発表賞の表彰制度を用意しております。

### 申込方法

下記URLに申込みホームページを設けますので、必要事項を記入して申込みを行ってください。

<http://sps-mste.jp/mate/>

**申込締切：2019年8月30日（金）**

論文採択決定後、論文発表の場合は4ページ又は6ページの論文を提出、またポスター発表者は2ページの概要を提出してください。原稿様式詳細はホームページを参照してください。

論文提出締切：2019年11月11日（月）

ポスター発表概要締切：2019年11月22日（金）

### 参加費

主催団体個人会員	：20,000円
主催団体シニア会員	：10,000円
大学・国公立研究機関	：20,000円
口頭発表者・座長	：20,000円
主催団体維持・賛助会員	：25,000円
共催団体会員	：25,000円
協賛団体会員	：30,000円
一般	：35,000円
学生	：10,000円

### 会場

パシフィコ横浜 会議センター

\* みなとみらい線 みなとみらい駅より徒歩3分

● JR線・市営地下鉄 桜木町駅より徒歩12分

● \* 横浜駅よりタクシー7分、シーバス（船）で10分



#### カテゴリーA 工 法

- A-1 固相接合
- A-2 ソルダリング
- A-3 ろう付
- A-4 溶接
- A-5 接着
- A-6 ナノプロセッシング
- A-7 成膜
- A-8 印刷
- A-9 ビーム加工
- A-10 エッチング
- A-11 マイクロ加工
- A-12 塑性加工
- A-13 システム化・統合化
- A-14 その他

#### カテゴリーB 研究・開発の観点

- B-1 金属材料
- B-2 有機材料
- B-3 複合材料
- B-4 加工プロセス
- B-5 アセンブリプロセス
- B-6 メカニズム・現象解析
- B-7 接合・界面構造
- B-8 信頼性
- B-9 解析・シミュレーション
- B-10 機能設計・システム
- B-11 熱マネジメント
- B-12 設備・機器
- B-13 検査・評価
- B-14 計測・分析
- B-15 生産システム
- B-16 その他

#### カテゴリーC 対象形態・製品

- C-1 デバイス
- C-2 パッケージ（3D, ウェハレベル等）
- C-3 モジュール（パワー）
- C-4 モジュール（車載, 光, LED等）
- C-5 MEMS・センサー
- C-6 実装部品
- C-7 基板（PCB, インターポーザ等）
- C-8 エネルギー変換機器
- C-9 車載機器
- C-10 通信・携帯機器, コンピュータ
- C-11 光学・表示機器
- C-12 医療・バイオ機器
- C-13 航空宇宙機器
- C-14 その他